

## NC273LT 免洗焊锡膏

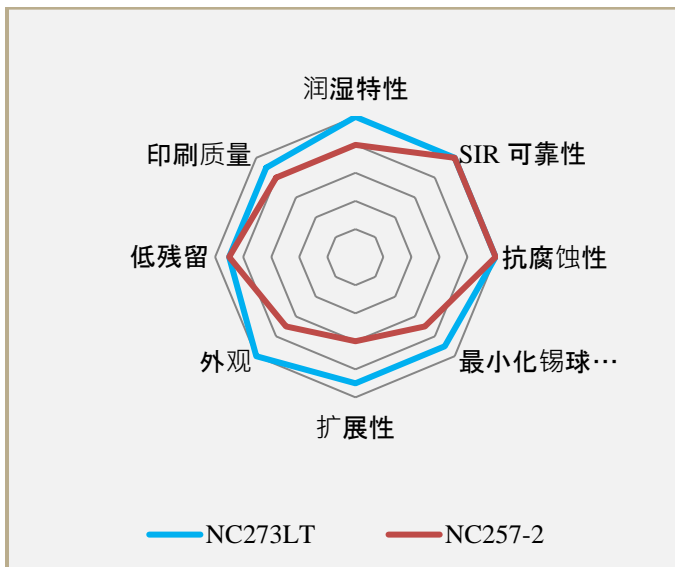
### 特性

- 专为低温应用而开发
- 符合 RoHS
- 提高铋系合金湿润性
- 最少的锡球缺陷
- 8 小时以上钢网上寿命

### 描述

AIM 的 NC273LT 低温焊锡膏的革命性活化剂系统，显著地提升了含铋合金对符合 RoHS 标准的电镀层和表面处理层的润湿性能。NC273LT 能提供较长的钢网寿命、优异的印刷效率，并能最大程度减少高铋合金常见的锡珠现象。当组装工艺中的热暴露受到限制时，NC273LT 是符合 RoHS 标准的理想产品。含铋焊锡膏可将峰值回流焊温度要求降至 170°C-185°C (338°F-365°F)。与任何含铋合金一样，组装工艺必须确保无铅。

### 特性



### 操作和储存

参数	时间	温度
冷冻密封保质期	6 个月	< 0°C (32°F)
冷藏密封保质期	4 个月	0°C-12°C (32°F-55°F)
非冷藏密封保质期	2 周	< 25°C (< 77°F)

请勿将使用过的焊膏添加到未使用过的锡膏中。使用过的锡膏要与未使用过的锡膏分开储存；对未使用的锡膏，要将内盖或顶盖盖好并重新密封。开封后锡膏的保质期取决于环境和应用，详情请见 AIM 焊膏使用指导。合金的成分和贮存条件可能会影响保质期。请参阅 NC273LT 分析证书中的特定信息。

### 清洗

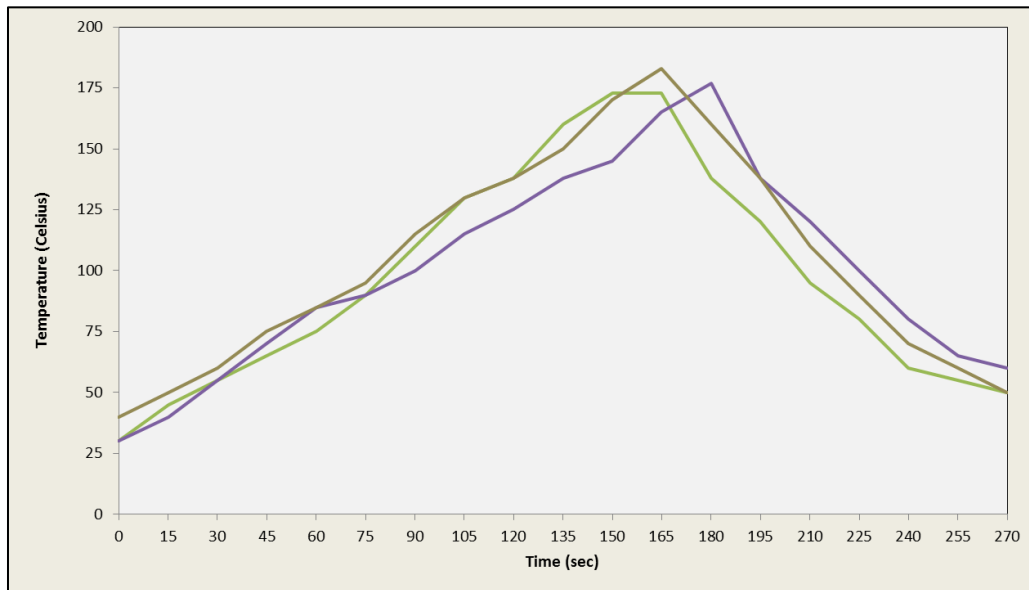
回流前:使用 AIM DJAW-10 可有效清洗 NC273LT 焊锡膏。DJAW-10 可自动或手动擦拭钢网。DJAW-10 不会使 NC273LT 干燥，但可加强其印刷性。切勿过量使用 DJAW-10。请勿将 DJAW-10 用于钢网顶部。不建议在工艺过程中使用 异丙醇，仅适用于最后清洗  
回流后残留物: NC273LT 可能会在回流后有残留存在在元件上，但无需清洗。在必须清洗的情况下，AIM 已与其工业合作伙伴合作确保 M8 残留物可使用普通除焊剂清洗。联系 AIM 获得清洗剂兼容性的信息。

\*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询 AIM 相关条款。

## 回流曲线

阴影部分标示了推荐的温度曲线窗口，您的实际曲线可能与之存在差异。元件限制条件、回流炉效能、PCB 板尺寸/质量、元件类型及密度均会影响最优回流曲线的设定。这些建议仅供参考。如需曲线优化协助，请联系 AIM 公司。



升温斜率最大每秒 1-3° C / SEC	升温到 100° C (212° F)	100° C 到 140° C (212° F-284° F) 之间的时间	170° C-185° C (338° F-365° F) 到达峰值时间	138° C (280° F) 温度以上	冷却速度 ≤ 4° C / SEC	冷却时间
	≤ 75 秒	30-60 秒	45-75 秒	50-80 秒	45± 15 秒	2.75-3.5 分钟

## 印刷

以下推荐的印刷机初始设定取决于 PCB 和 PAD 设计	
参数	推荐初始设定
刮刀压力	0.9 - 1.5 磅/英寸每刀片
刮刀速度	0.5 - 6 英寸/秒
接触距离	接触 0.00 毫米 (0.00 英寸)
PCB 分离距离	0.75-2.0 毫米 (.030-.080 英寸)
PCB 分离速度	3.0 - 20.00 毫米/秒

\*所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

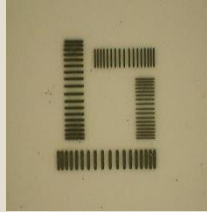

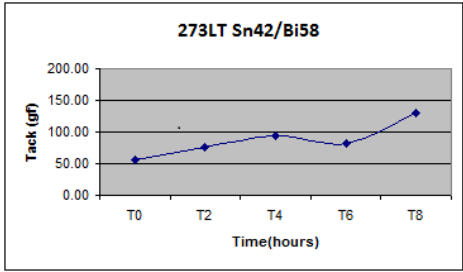

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询 AIM 相关条款。

## 测试数据总结

项目	测试方法	结果	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004 3.2.3.1	ROL0	
IPC 助焊剂分类	J-STD-004B 3.3.1.2.1	ROL1	
项目	测试方法	典型值	图片
铜镜	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>后</p>  </div> </div>
定量卤化物	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	溴: 0.23% 氯: 0.0% 典型值	
卤素含量	EN14582	通过	无卤素
定量卤化物、铬 酸银测试	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	
定量卤化物、氟 化点	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	不含氟	
表面绝缘电阻	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	通过	
助焊剂固体含 量、非挥发性测 定	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	3.17 典型值	
酸值测定	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	159.4 mg KOH/ g flux	
助焊剂比重测定	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	0.98	
粘度	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	印刷配方: 750kcps 典型值 点涂配方: 400kcps 典型值	

\* 所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。

项目	测试方法	正常值	图片
外观	J-STD-004B 3.4.2.5	灰色, 平滑, 粘稠	
坍塌测试	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	通过	
锡球测试	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	通过	
粘性	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	55. 3gf	
润湿度	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	通过	

\* 所有信息仅供参考。不作为特定来料产品规格说明或工艺设计。有关特定产品的信息，请参阅分析证书。

免责声明 以上信息免费提供，产品信息根据正确的处理和操作条件提供。如未按信息中的正确方法使用或未按指定材料生产，造成的损失或伤害，不在责任承担范围内。详情请登入 <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> 查询AIM相关条款。